



For Details Contact:

Kim Anderson
Xandex, Inc.
Phone 707. 763.7799 ext 144
Email kanderson@xandex.com

Xandex, Inc.
1125 North McDowell Blvd.
Petaluma, CA 94954
USA

For Immediate Release

2003 年 12 月 1 日 東京

カリフォルニア州ペタルーマを拠点とする Xandex Inc. は、2003 年 12 月 3 日 ~ 5 日の セミコン・ジャパン 2003 (ブース 9-B306) において、半導体検査インターフェイスの画期的な新製品 **Xandex Zero Insertion Force (XZIF)** インターコネクト ソリューションを発表致します。

XZIF インターコネクトの概要

XZIF インターコネクトは、多ピン半導体検査インターフェイスの様々な問題を解決し、インターフェイス に関わるコストを削減する画期的な技術です。

従来のスプリング プローブによる接続方式と、バックプレーン コネクタ接続方式からさらに進展した XZIF インターコネクトの接続方式は、最新の **パンプ オン フレックス** 技術を採用しております。

XZIF は次世代検査システムとして米国大手 ATE メーカーが既に採用しており、従来の接続方式より大幅にコストを削減し、ATE プラットホームが求める高密度と平行度を実現しております。

XZIF の特長

<従来方式の問題点>

デバイス側のピン数が増えるに伴い、ボードとテスト側との接合に必要なコンタクトピンの数も多くなり、高密度で且つ平行度が要求されます。特にメモリ検査プラットフォームにおいては、インターフェイスのコストが高くなり、また接続時に大きな加圧力が必要となります。スペース加圧力が大きくなると、ボードの複雑さが増し水平度の維持が難しくなります。これらの理由で次世代の検査プラットフォームが開発される度にボードのコストが上昇しております。

<XZIF 方式>

XZIF インターコネクットは、これらの課題を全て解決します。高密度なメモリ検査での使用に適合する XZIF の**バンブ オン フレックス**では、1 チャンネルごとのコストをスプリング プローブより低く抑えており、より高密度なチャンネルが可能になります。また加圧力が最小に出来たことで、XZIF では DUT ボードの偏向と配置の問題をなくし、また、高価な材質の基板が不要となります。

XZIF は、ピン数と同じスプリング プローブ方式に比べ、接続コストが 50% 削減可能です。接合部分の金バンブは、5,000 回を超えるコンタクト サイクルにおいても安定したコンタクトを維持する信頼性と耐久性を保証します。スプリング プローブの様な加圧の必要性がないため、XZIF は機械的または真空による結合メカニズムを使用することなく、非常に信頼性の高い安定した接触抵抗を実現します。

電気的特性

XZIF インターコネクット(特性インピーダンス 50 Ω)の電気的特性は、以下の通りです。

帯域幅	−3dB で > 1GHz
接触抵抗	< 10 mΩ
定格電流	1 A

Xandex Inc. について

Xandex Inc. は、半導体産業に画期的な検査ソリューションを提供しております。

弊社は、半導体ウェーハ マーキング ソリューションにおいて最大手サプライヤーです。また、ATE (自動検査機器) メーカーに対する検査インターフェイス製品の納入においても、大手サードパーティ サプライヤーであります。これらの製品は、世界 27 ヶ国、1,000 ヶ所以上の半導体製造工場で数多く使用されております。

弊社の製品は、DieMark® インキング システム、ATE インターフェイスおよびドッキング ソリューション、Xandex 伝送線 (XTL) ケーブルとコネクタがあります。弊社は、ISO 9001 : 2000 に認証登録されており、自社製品については複数の特許を取得しております。

弊社の製品は、本社と工場のあるカリフォルニア州ペタルーマで製造されており、北米およびヨーロッパに販売されています。また、販売店を通じて、アジア地域における販売やカスタマー サポートの業務を行っております。詳細については、www.xandex.com をご覧ください。

新製品 XZIF インターコネクトおよび伝送線ソリューションの全製品の詳細については、セミコン・ジャパン 2003 ブース番号 9 - B 3 0 6 にお立ち寄りください。

